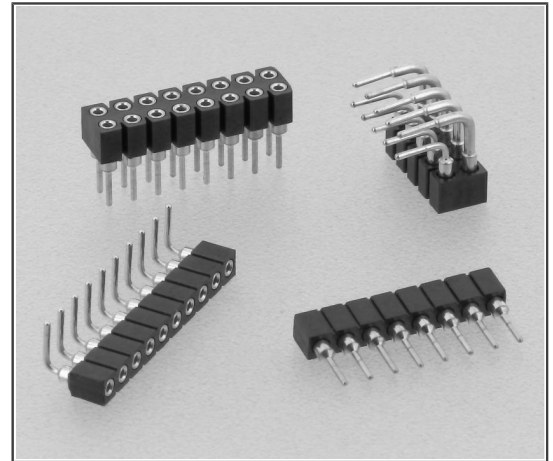


Präzisions-Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt, 1-/2-reihig **Precision Female Headers, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled, Single/Double Row**

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht
	Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	Sleeve: screw machined brass
	Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	< 10 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Test Voltage	1 kV RMS
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
Voltage Rating	100 V RMS / 150 V DC
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	Wave or reflow soldering

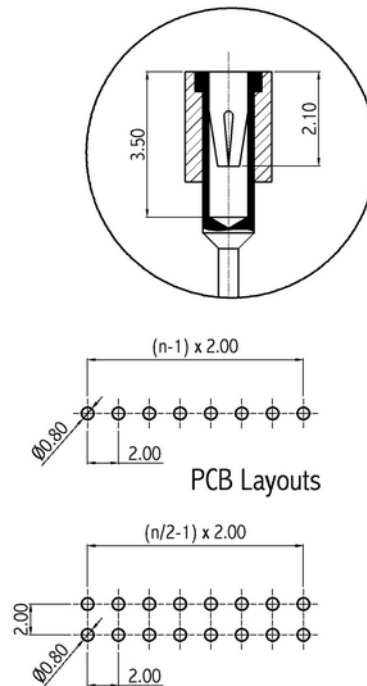
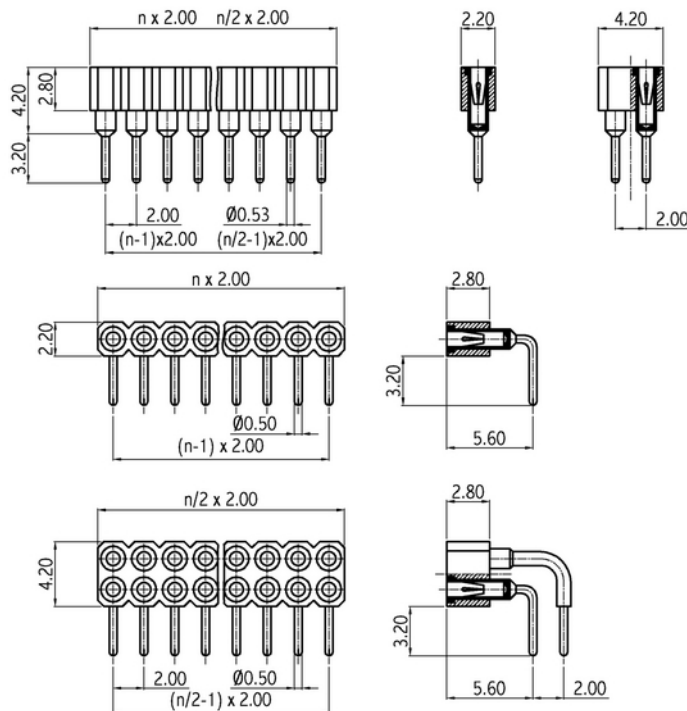


Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.

Für Vierkantstifte 0,50mm: Option 6.

For Ø0.40-0.56mm round pins or 0.25x0.45mm rectangular pins.

For 0.50mm square pins: Option 6.



PCB Layouts

Series	Contacts*	Type*	Sleeve Plating	Clip Plating*	Clip (Optional)*
TC-0514	72	4	50	00	6
	01-50 Einreihig Single row 02-100 Zweireihig Double row	1 Einreihig, gerade Single row, straight 2 Zweireihig, gerade Double row, straight 3 Einreihig, gewinkelt Single row, right-angled 4 Zweireihig, gewinkelt Double row, right-angled	50 Hülse verzinkt Tin plated sleeve	00 Feder vergoldet Gold plated clip 10 Feder 0,25µm Gold (Option) 0.25µm gold plated clip (Option) 30 Feder 0,75µm Gold 0.75µm gold plated clip 50 Verzinkt Tin plated	6 6-Lamellen-Clip für Vierkantstift 0,5mm 6 Finger Clip for square pin 0.5mm

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

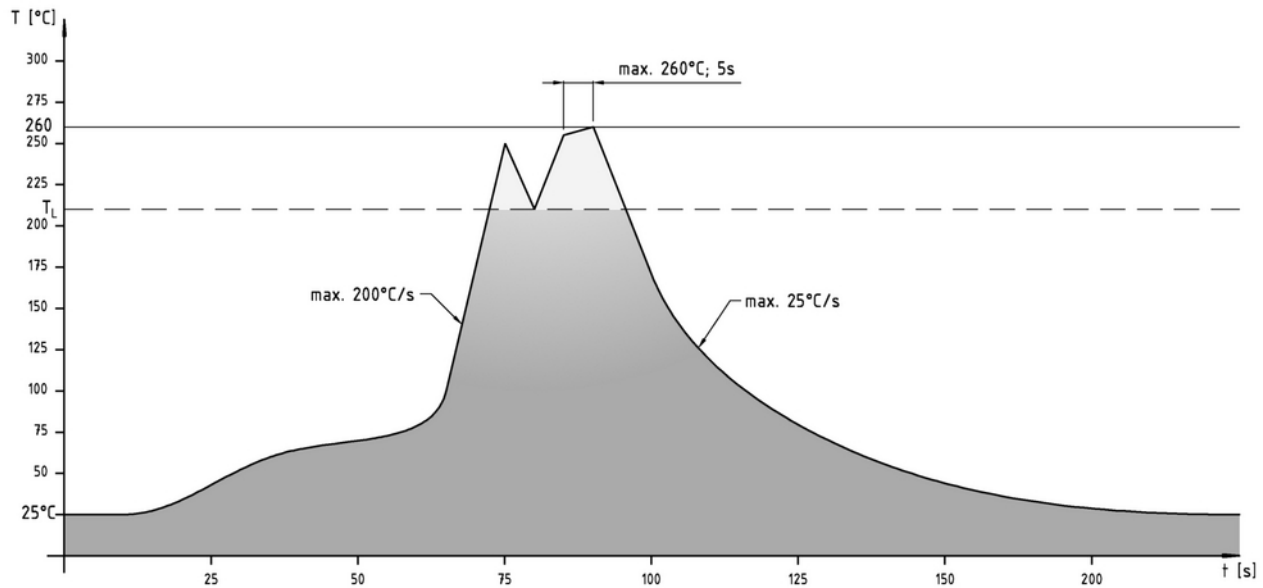
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

